

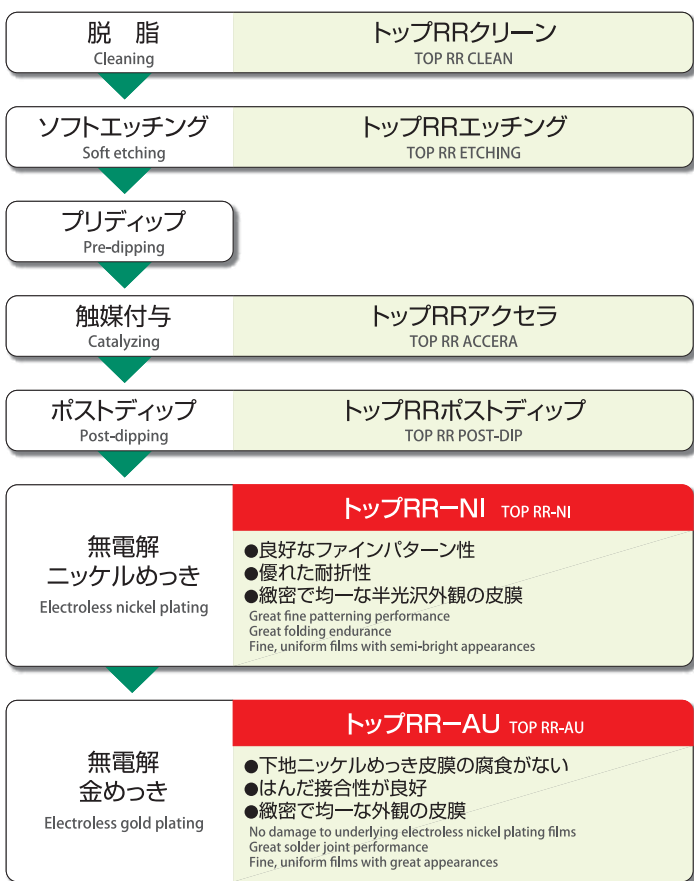
Roll to Roll 装置による連続生産に対応した無電解ニッケル/金めっきプロセス トップRRプロセス

Electroless Ni/Au Plating Process for Flexible PWBs to Roll to Roll Plating System
TOP RR PROCESS

- Roll to Roll 装置による電気銅めっきから、連続して無電解ニッケル/金めっきができる
 - めっき皮膜は優れた耐折性により、搬送時のロールとの接触による断線がない
 - 独立回路基板の連続生産に対応し、均一な皮膜が得られる
- Can conduct electro-copper, electroless nickel- and gold-plating continuously with Roll to Roll plating system
 - Excellent in folding-endurance performance, prevent film damage by conveyors
 - Applicable to PWBs with isolated circuits, can obtain uniform films

処理工程

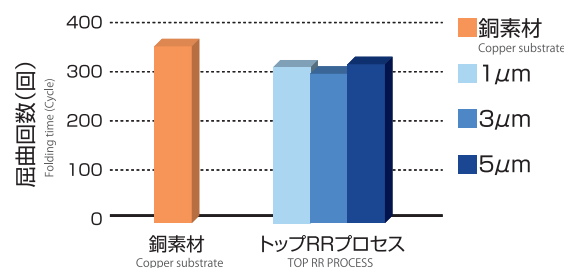
Process



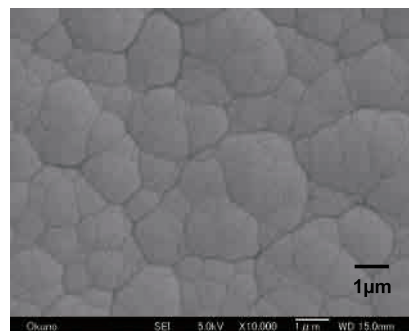
優れた耐折性

Excellent folding endurance

MIT試験 MIT folding endurance TEST



無電解金めっき液による
下地ニッケルめっき皮膜の腐食がない
Prevent nickel film damage by gold plating



金めっき皮膜剥離後の表面FE-SEM画像
SEM image of nickel film surface (After stripping gold plating film)

Roll to Roll 装置の外観

Roll to Roll plating equipment image

